

Composite-Entlötpitze SOP 16L - Hakko T8-1009

Artikel-Nr. HK-T8-1009

Hersteller Hakko

EAN 4962615010040

Kein Produktbild

Composite-Entlötpitze im Format SOP 16L für den Einsatz mit der parallelen Entlötpinzette Hakko FM 2022. Ermöglicht das präzise Entfernen von SMD-Bauteilen. Lieferung im 2er-Pack.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85159080
-----------------	----------

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T8-1009 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das System der parallelen Entlötpinzette FM 2022 entwickelt wurde. Im Format SOP 16L ausgeführt, ermöglicht diese Spitze das effiziente und kontrollierte Entfernen von oberflächenmontierten integrierten Schaltkreisen und anderen kleinen Bauteilen von Leiterplatten, ohne die umliegende Schaltung zu beschädigen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Geometrie im Format SOP 16L für präzise Bauteilausrichtung
- Composite-Aufbau für optimale Wärmeübertragung und hohe Langlebigkeit
- Ausschließlich kompatibel mit der parallelen Entlötpinzette FM 2022
- Ermöglicht das gleichzeitige Erhitzen mehrerer Bauteilanschlüsse
- Reduziert die thermische Belastung von Leiterplatte und benachbarten Bauteilen
- 2er-Pack für einen verlängerten Betriebseinsatz

ANWENDUNGEN

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an integrierten Schaltkreisen im Small-Outline-Package (SOP) mit 16 Anschlüssen. Häufig eingesetzt in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung und bei Reparaturen auf Bauteilebene, wo präzises Entlöten erforderlich ist.

LIEFERUMFANG

- 2 x Composite-Entlötpitze Format SOP 16L